

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位 及人员	UBS-Jimmy Yu UG Investment-Kevin Yang	GaoTeng Global Asset Management Limited -Junjie Zhang Neo Criterion-Qing Xu
时间	2024年11月25日	
地点	公司A403会议室	
接待人员	董事长潘连胜博士、董事会秘书常亮先生	
投资者关系 活动主 要内容介 绍	<p>一、 对海外市场的预期</p> <p>公司大直径硅材料产品，通过海外硅零部件生产厂商，直接或间接地进入到终端用户即海外芯片制造厂商。</p> <p>今年以来，海外市场需求有所恢复，主要系海外科技巨头对AI数据中心的巨额资本开支拉动：一方面增加了等离子刻蚀机的出货，另一方面还提高了海外芯片制造厂商的开工率。</p> <p>目前，海外市场的终端消费需求尚未实质恢复，智能手机、个人电脑出货量增长疲软。新兴消费电子产品品类，例如折叠屏手机、超薄手机、AI手机、AI个人电脑、AI可穿戴设备、具身智能机器人等，截至目前出货量尚未达到一定量级，渗透率不高，对半导体周期景气度的推动作用仍有待观察。</p> <p>公司作为上游材料及零部件厂商，密切关注并跟踪海外市场变化。进入年末，公司对2025年各项经营规划正在讨论编制中，会结合下游客户的预期进行调整。</p>	

二、 对中国本土市场需求的评估

公司大直径硅材料产品，除向海外市场出口外，国内市场销售也快速增加；公司硅零部件及半导体大尺寸硅片产品，面向国内市场销售。

今年以来，中国本土市场需求逐渐恢复。特别是第三季度以来，下游家电产品在政府专项消费补贴的带动下销售量增加，也相应地拉动了中国本土集成电路制造厂商的开工率，因此也一定程度上拉动了上游零部件和材料的需求。

目前，中国本土的集成电路制造厂商和生产设备制造商，国产化水平已经较2018年取得长足发展。在看到成绩的同时，我们同样观察到，中国仍在零部件及材料领域存在很多短板，亟待补齐、加强。

公司有意愿和能力，在这一进程中发挥独特作用，也相信公司将在这一进程中获得持续的需求并发展壮大。

三、 投资计划和扩产进度

从公司三大主营业务来看，大直径硅材料业务扩产有序推进中，目前公司产能已处于全球领先地位，能够满足未来数年内可能持续增长的下需求；硅零部件业务，受益于国产等离子刻蚀机原厂赶超国际先进水平所带来的需求，订单充足，开工率较高，正在根据下游订单实际情况，持续扩产；大尺寸半导体硅片业务，募投项目已经结项，目前没有新增投资计划，公司正在持续推进产品评估认证工作。

四、 如何拓展更多品类并扩大经营规模

公司已有三大主营产品，即大直径硅材料、硅零部件、大尺寸半导体硅片，都是围绕着公司既有的硅材料技术核心优势所建构。未来，公司仍将稳扎稳打，围绕核心优势有序扩展更多产品品类；在合适的时机采用外延式发展战略，打开更大的发展空间。

附件清单	无
日期	2024年11月27日